

# FrameScanPlus 0.375×0.475 inch OTC-TD-FS-SP-013-010

产品 14763



直接訪問產品

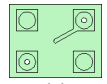
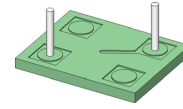
ingun®

Partner for Future Technology

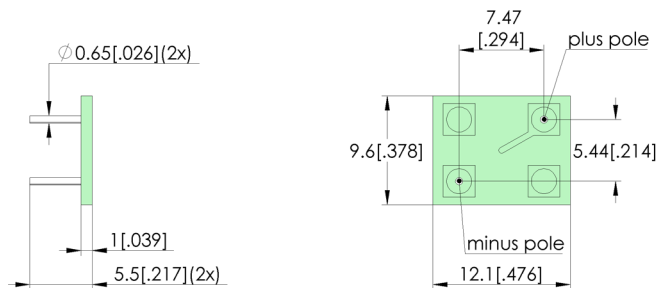
- 开路测试用组件, 用于半导体芯片的电容式测试, 检测其是否断裂、短路和存在焊接缺陷
- 适用于 Teradyne 测试系统

## 使用

FrameScan Plus 传感器板用于集成电路的电容测试, 可检查集成电路内部的接线接口是否存在断裂、短路和缺陷焊接。



1:1



## 一般数据

产品组:	开路测试
结构系列:	OTC
类型:	Teradyne opens test
规格:	
配件类型:	扩展配件
交付状态:	传感器板 013-010
宽度:	9,6 mm
高度:	5,5 mm
重量:	0,01 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

## 适用于

真空测试治具 (VA):	VA 20xx
替换套件 (WS):	替换套件 Teradyne/TSH5x

## 技术数据

长度:	12,1 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	9,6 x 12,1 x 5,5 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。04/26\_CN